

## Tri-Continental Master in Advanced Architectural Design

### 建築デザイン・3大陸マスターコース

#### <事業内容>

1. 主催：Universidad Europea de Madrid, School of Architecture（私立）
2. 学位：修士
3. 分野：建築および都市
4. 期間：9か月（計500時間：60 ECTS<sup>1</sup>単位）／2014年1月～9月
5. 留学先：
  - 5.1 UEM-EA, Madrid, SPAIN／2014年1月～3月  
Universidad Europea de Madrid, School of Architecture
  - 5.2 TJAD, Shanghai, CHINA／2014年4月～6月  
Tonji University, Architectural Design and Research Institute
  - 5.3 NSD, San Diego, USA／2014年7月～9月  
New School of Architecture and Design
6. 使用言語：すべて英語のみ
7. 学費：15,000ユーロ（約186万円：124円／ユーロとして）  
この学費には、同済大学（中国上海市）学生寮費を含む。
8. その他の費用：
  - 8.1 航空運賃、ビザ・保険費用、その他交通費
  - 8.2 マドリッドおよびサン・ディエゴにおける宿泊費
  - 8.3 全期間の食費、生活費 等
  - 8.4 宿泊・生活費の目安（2013年1月現在）
    - 1) マドリッド：約800ユーロ／月（2人でシェア・アパート＋食費＋交通費）
    - 2) 上海：約300ユーロ／月（食費＋交通費）←宿泊費は学費に含む
    - 3) サン・ディエゴ：約1,000ユーロ／月（2人でシェア・アパート＋食費＋交通費）

#### <支援内容>

9. 一般財団法人国際建築活動支援フォーラム（JSB）による支援内容：
  - 9.1 学費（7. 参照）の全額支給（返済不要）：その他の費用はすべて本人が負担する
  - 9.2 選考の代行、および主催者との調整
  - 9.3 主催者との連絡・調整
10. JSBによる支援対象者人数：2014年は2名までとする

---

<sup>1</sup> European Credit Transfer and Accumulation System

## 11. 選考過程：

### 11.1 必要書類の提出

- 1) 提出先：国際建築活動支援フォーラム（東京都渋谷区神宮前）
- 2) 提出期限：2013年4月30日（郵送の場合、当日消印有効）
- 3) 提出書類（全て英文表記のこと）
  - ①学歴・履歴書
  - ②応募者による作品のポートフォリオ（A3版20ページ以内+CD）
  - ③英語能力を示す証明書（TOEFL、TOEIC、EIKEN等）
  - ④国際経験を示す書類（国際交流プログラムや国際会議への参加経験、留学経験、国際的な奨学金受給あるいは受賞経験等）
  - ⑤英文で記載された応募動機（A4版1枚程度）

### 11.2 英語による面接（一人20分程度）

- 1) 対象者：必要書類を全て提出した応募者
- 2) 日時：2013年5月11日（土）13:00～
- 3) 場所：国際建築活動支援フォーラム（東京都渋谷区神宮前）

### 11.3 選考上の配点の目安

- 1) 面接：20%
- 2) 英語能力：20%（例えば TOEFL iBT 60=0%, TOEFL iBT 120=20%）
- 3) ポートフォリオ：30%
- 4) 国際経験：30%

### 11.4 主催者による最終インタビュー

- 1) 対象者：上記により JSB が選抜した応募者（最大2名）
- 2) Skype による UEM-EA 担当者との国際面接（20分程度）
- 3) 日時：2013年5月末日夕刻（日本時間）予定
- 4) 場所：国際建築活動支援フォーラム（東京都渋谷区神宮前）
- 5) 結果通知：2013年6月上旬

## 12. 担当窓口

### 12.1 UEM-EA, Madrid, SPAIN

Professor Pedro Pablo Arroyo Alba  
PEDROPABLO.ARROYO@uem.es

### 12.2 一般財団法人 国際建築活動支援フォーラム（JSB）

東京都渋谷区神宮前 2-3-18 JIA 館5階  
Tel. 03-5411-7271, Fax. 03-5411-1182

岩村 和夫（評議員・東京都市大学教授）  
iwamura@tcu.ac.jp